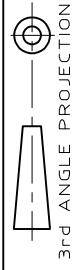


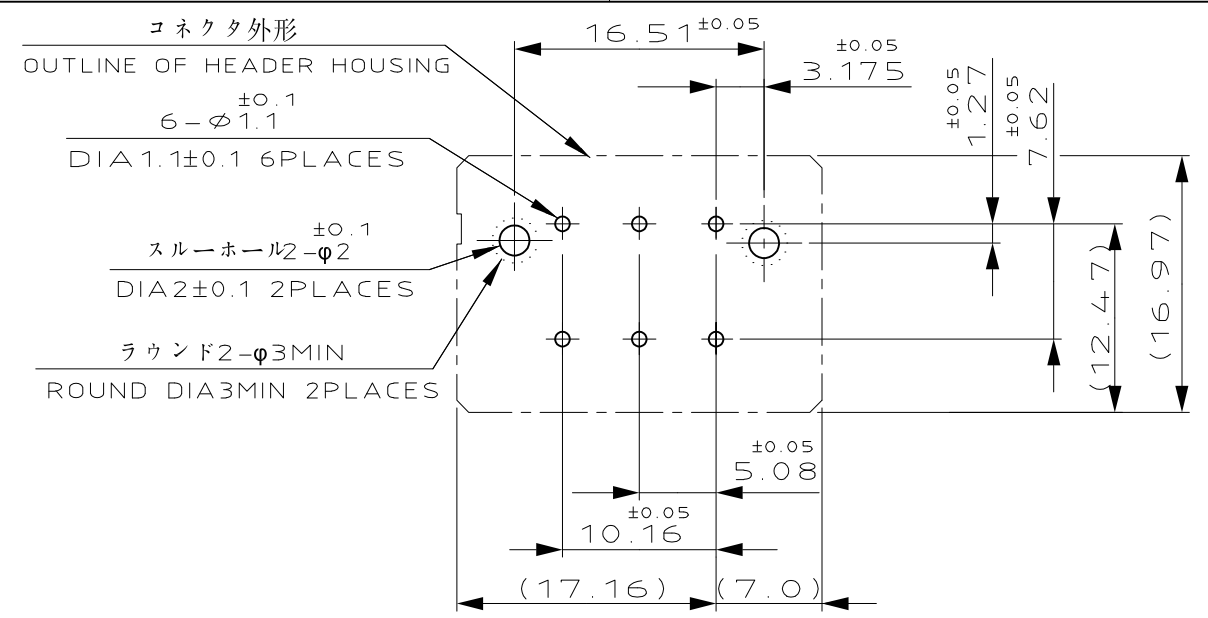
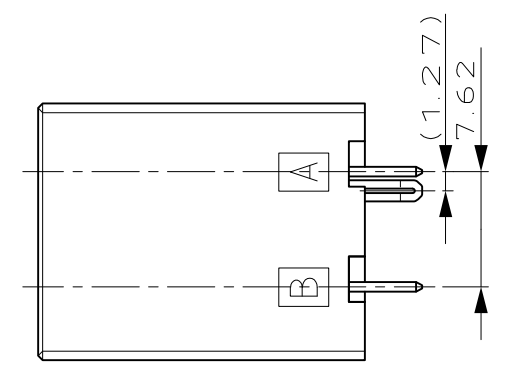
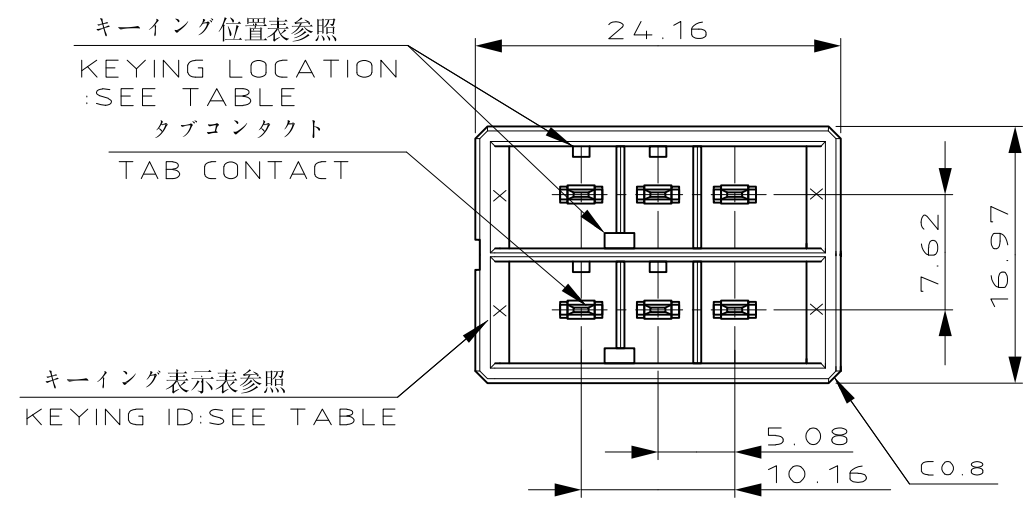
NUMBER 178140



METRIC

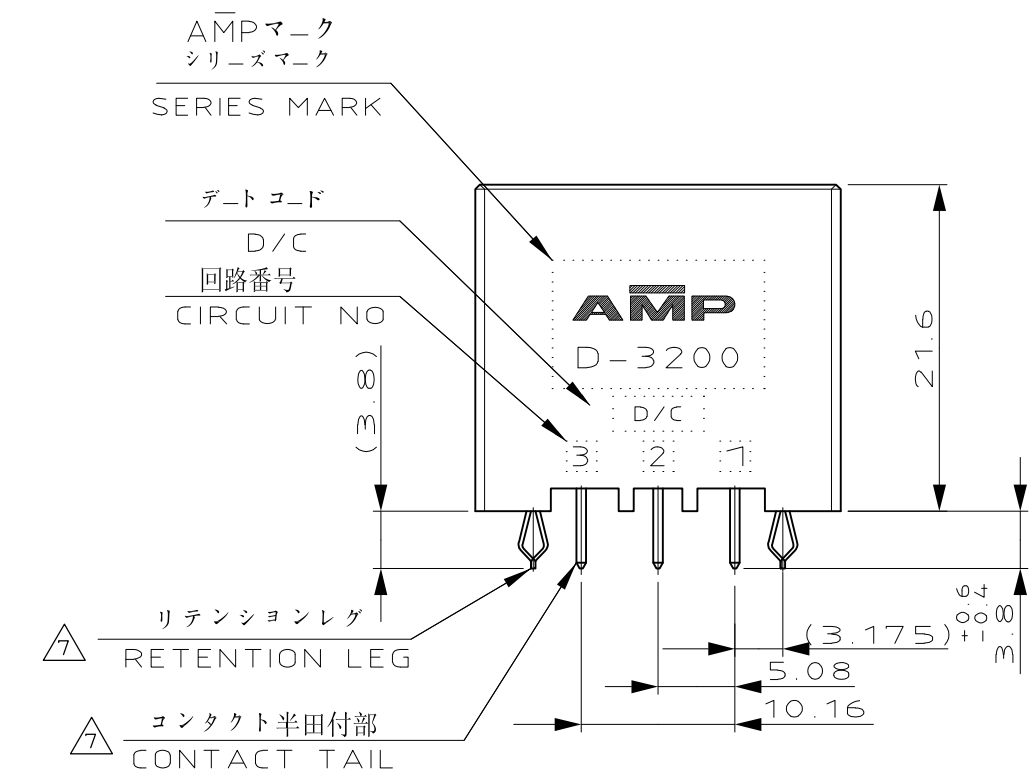
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FOR DRAWER
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト全面Ni下地 接触部 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト全面Ni下地 接触部 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト全面Ni下地 接触部 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 ニッケル下地の上に半田めっき
- ドロー用
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 ニッケル下地の上にスズめっき

A ROW		X	Y	△7 △4	3-178140-5
B ROW		X	Y	△7 △3	3-178140-3
A ROW		Y	Y	△7 △2	3-178140-2
A ROW		Y	Y	△7 △4	2-178140-5
B ROW		Y	Y	△7 △3	2-178140-3
B ROW		Y	Y	△7 △2	2-178140-2
A ROW		X	X	△7 △2	△6 4-178140-2
A ROW		X	X	△7 △4	1-178140-5
B ROW		X	X	△7 △3	1-178140-3
B ROW		X	X	△7 △2	1-178140-2
KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.

						<b>TE</b> TE Connectivity	
				WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
				mm?(AWG - )	mmφ	DYNAMIC D-3200 5.08X7.62PITCH(V) 6 POS.HDR CONN.ASS'Y	
				MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
				SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	SIZE LOC NUMBER	
				DR. 19 APR 94	DE. 19 APR 94	A3 J C=178140	
				N. Matsubara	N. Matsubara	SCALE REV. SHEET	
				CHK. 20 APR 94	APP. 20 APR 94	2-1 F1 1 OF 1	
				S. MANABE	S. MANABE		
F1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR 11			
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE			